

課題番号 : F-16-WS-0075  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : パワーデバイス計測のための半導体パラメータアナライザに関する技術相談  
Program Title (English) : Technical consultation on semiconductor parameter analyzer  
利用者名(日本語) : 畢 特  
Username (English) : BI Te  
所属名(日本語) : 早稲田大学電子物理システム学科  
Affiliation (English) : Department of Electronic and Physical Systems, Waseda University

## 1. 概要(Summary)

パワーデバイスの計測においては、パルス電圧の印加等通常とは異なる計測条件でデバイスの電気特性を取得することが必要となる。この計測条件は計測結果を見ながらトライ&エラーで決めていかなければならない。

今回、特殊小型パワーデバイスのプロービングと特性計測を、支援員より実際に計測結果を確認しながら、測定条件の設定と治具(Fig.1)の製作、および基本的なパワーデバイスの測定の考え方について相談した。これらに基づき、種々検討した結果、半導体パラメータアナライザによる上記パワーデバイスの電気特性の計測が可能となった。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

## 6. 関連特許(Patent)

なし

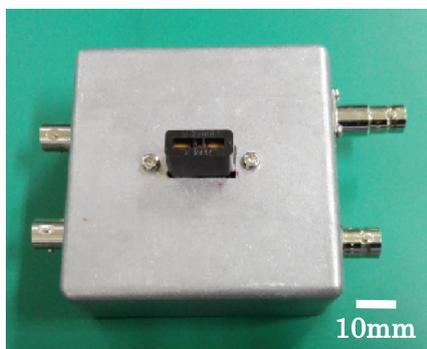


Fig.1 Photograph of a conversion jig.

## 2. 実験(Experimental)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。